



SCIENTECH

辛耘 (3583)

2017年11月29日

免責聲明

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

基本資料

成立時間 1979/10/17

上市時間 2013/3/12

資本額 8.11億元

董事長 謝宏亮

總經理 許明棋

主要業務 自製設備、晶圓再生、設備代理

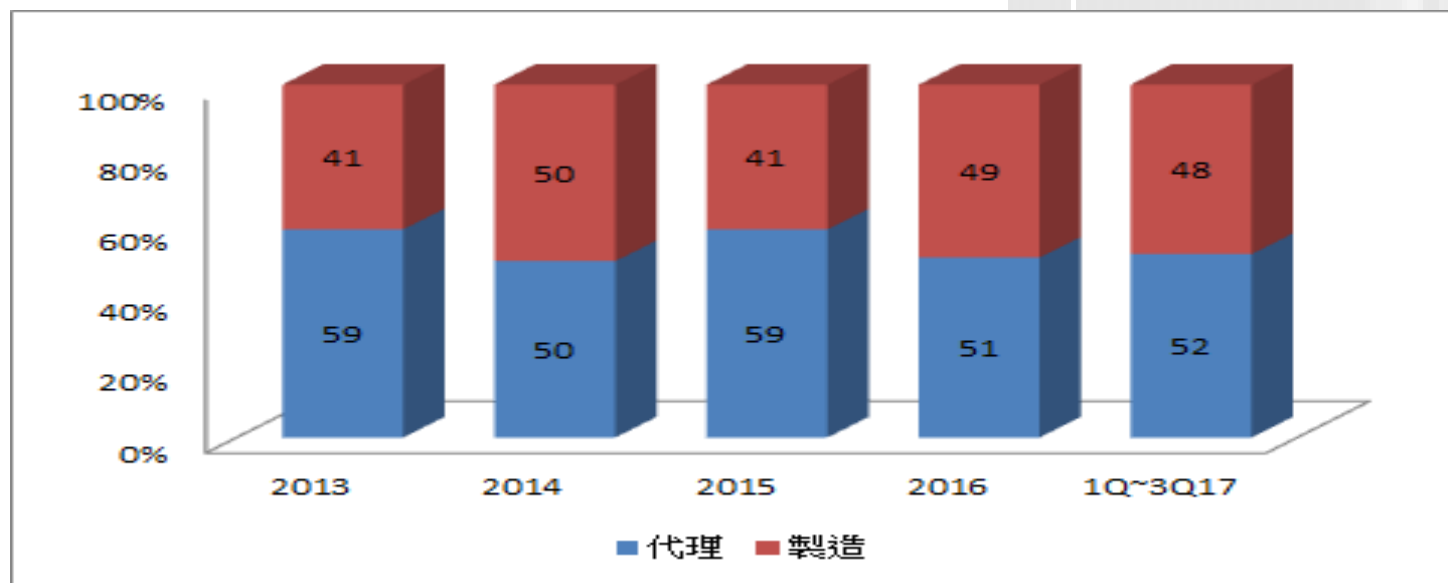
營運概況

主要產品

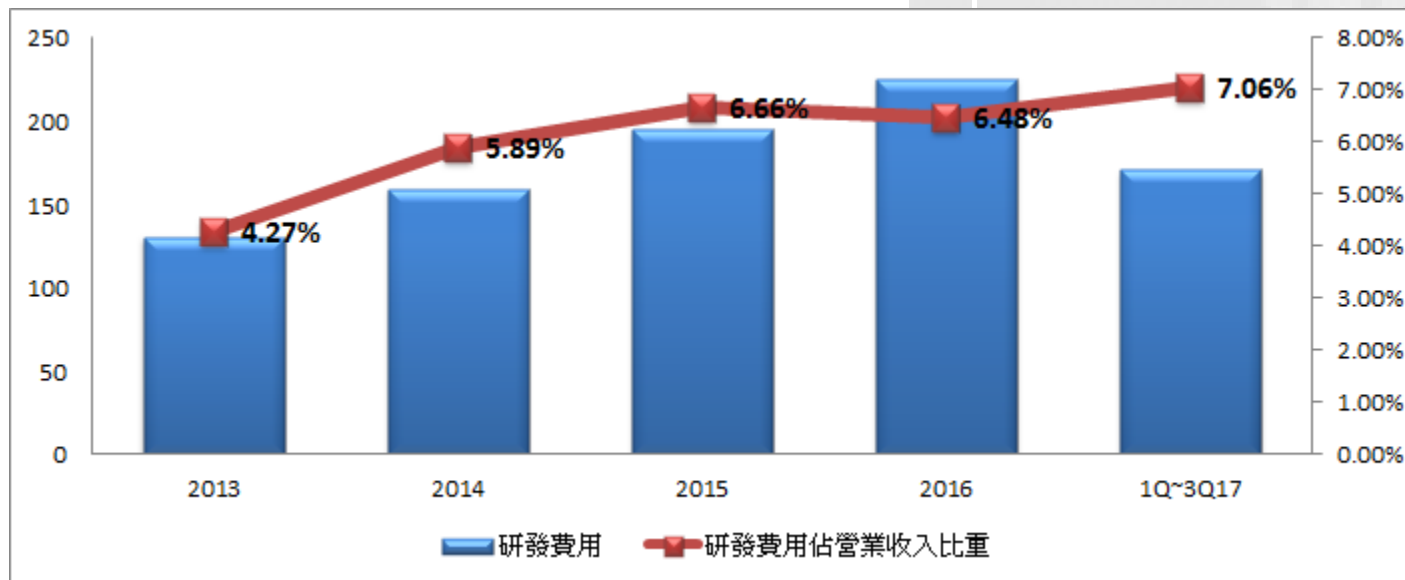
未來展望

單位：百萬	2013	2014	2015	2016	3Q17	1Q~3Q17
營業收入	3,068	2,717	2,942	3,495	885	2,428
營業毛利	983	970	903	1,178	335	864
營業費用	629	673	779	835	215	611
營業淨利	354	297	124	343	120	253
營業外收入及支出	(26)	20	(6)	21	(15)	(26)
稅前淨利	328	317	119	363	105	227
本期淨利	249	246	86	292	86	177
EPS(元)	3.11	3.04	1.06	3.60	1.06	2.18
毛利率	32.04%	35.71%	30.69%	33.71%	37.91%	35.60
營業淨利率	11.53%	10.93%	4.23%	9.80%	13.62%	10.44%
稅前淨利率	10.69%	11.68%	4.03%	10.40%	11.86%	9.33%

單位：%	2013	2014	2015	2016	1Q~3Q17	毛利率
代理	59	50	59	51	52	低於平均
製造	41	50	41	49	48	高於平均



單位：百萬	2013	2014	2015	2016	1Q~3Q17
研發費用	131	160	196	226	171
研發費用 佔營業收入比重	4.27%	5.89%	6.66%	6.48%	7.06%



自製
設備

濕製程設備

設備
代理

半導體暨光電
製程及量測設備

晶圓
再生

12吋晶圓再生

● 濕製程設備

■ 單晶圓/批次濕式製程設備

- ◆ 12"/8" 先進封裝製程(Fan-out、Solder Bump、Copper Pillow、Bumping、Gold Bump、RDL、TSV ... 等)
- ◆ 6"/8"/12" 半導體前段成熟特殊製程 (IoT Sensor、Power IC、FP sensor、RF、CMOS、Touch Controller、MEMS)
- ◆ **HBLED** 全自動前段製程 for 背光與照明
- ◆ **III-V**族 for 無線通訊高頻 IC (PA 與射頻IC)
- ◆ **MEMS** 微機電

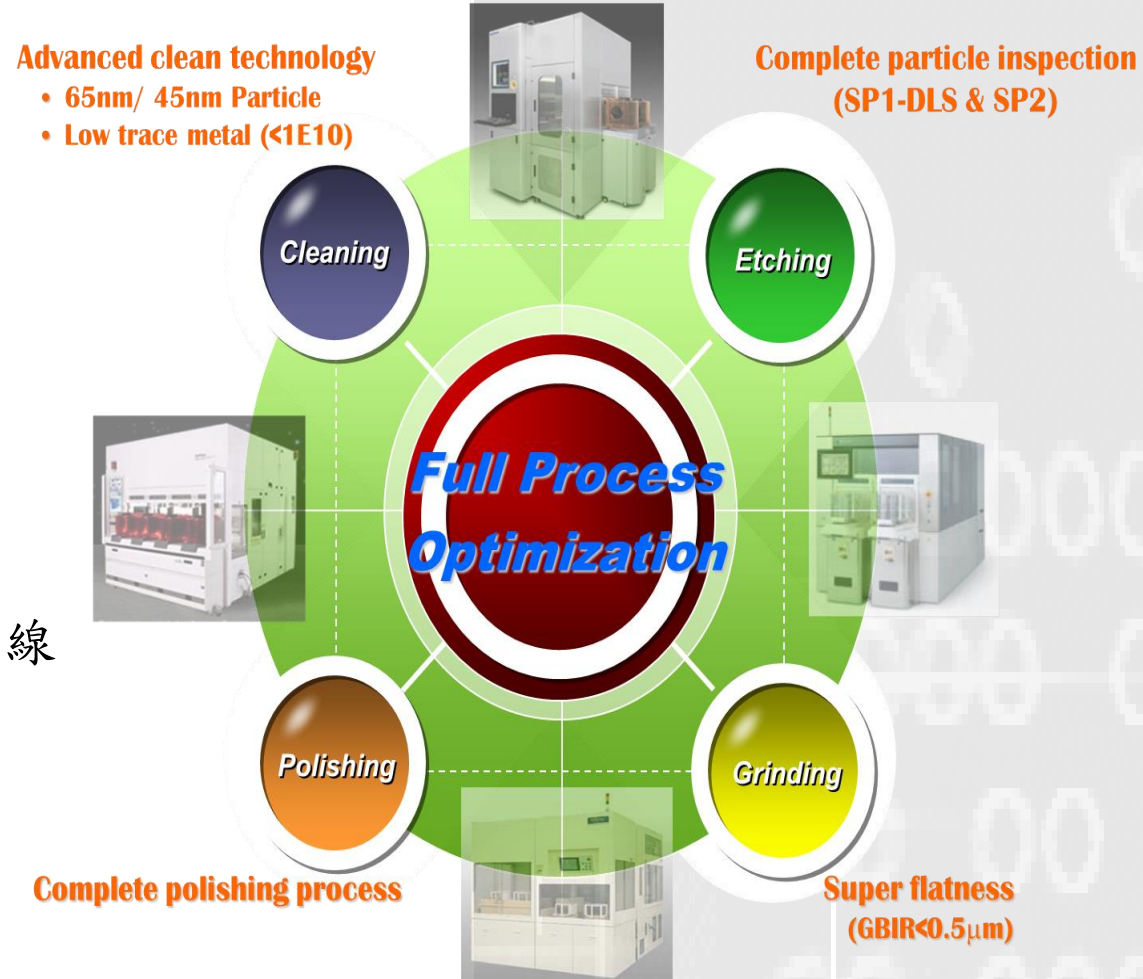


● Scientech Corp.



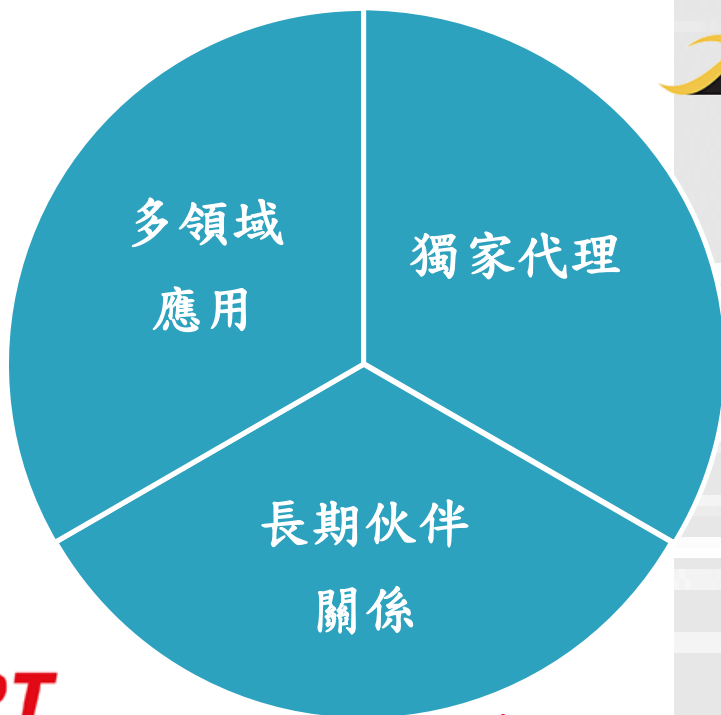
■ 12" 晶圓再生

- ◆ 月產能: 12 萬片
- ◆ 銅製程與非銅製程產線分離



主要產品

設備代理



Canon

Revera



ECO-SNOW SYSTEMS



FerroTec



Hirata



USHIO



自製
設備

濕製程設備

晶圓承載設備
全譜質譜儀

設備
代理

半導體暨光電
製程及量測設備

AMOLED

晶圓
再生

12吋晶圓再生

SiC晶圓再生

簡報結束
謝謝！

Q&A